

在OGS生产中省去二次强化工序的提案

请问是否在智能手机、平板电脑用OGS生产中遇到困惑？
我们只通过研削加工，便可提高OGS、LCD面板的钢化度。



Feature 1

利用陶瓷系的特殊砂轮和高刚性机械来实现镜面化加工

Feature 2

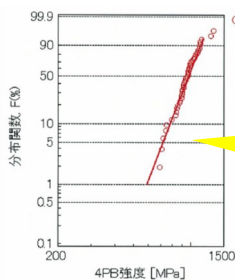
削减倒角加工之后的二次强化工序

Feature 3

搭载2个加工平台和2套上下料系统的占地面积小，又拥有高产能的设备

如此不同！

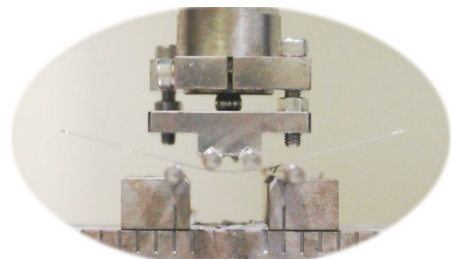
4PB



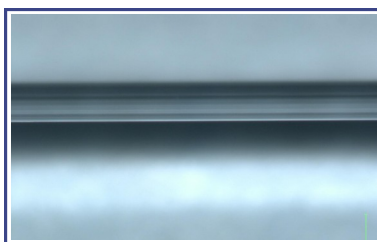
Weibull10%
可达到**780MPa**
平均**967MPa**

[条件]

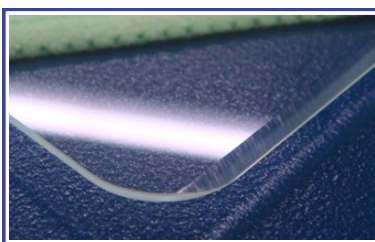
- 10-20 5mm/min
- t0.55 CS:780MPa



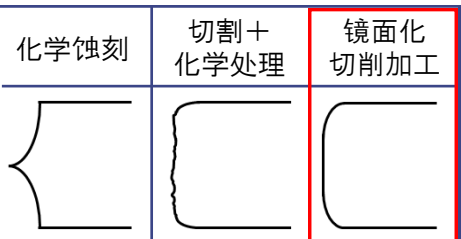
理想的端面



镜面



可以实现2.5D加工



理想的端面

减少二次强化工序

可实现制造工艺的短缩，成本和工时的降低
没有废液处理等的麻烦

Contact us
DAITO ELECTRON CO.,LTD.

大途电子(上海)有限公司
上海市淮海中路398号世纪巴士大厦9楼F座
TEL: +86-21-6093-2193 (石)
<http://www.daitron.com.cn/>

日商大都電子股份有限公司台北分公司
100-53 台北市中正區杭州南路一段19號11樓
TEL: +886-2-2394-5134 (高)
<http://www.daitron.com.tw/>